In-House Rapid PCB Prototyping

스루홀 도금 시스템 / ProConduct

무공해

■ 주요 특징

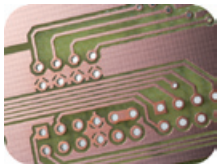
기존의 스루홀을 제작하기 위해 필요로 했었던 도금 탱크나 위험한 화학물질들은 필요치 않습니다. 이 컴팩트한 시스템은 설계자가 원하는 곳에서 매우 빠르고 편리하게 그리고 안전하고 정확하게 스루홀을 구현할 수 있습니다.

새로운 개념의 스루홀 장치로 전용 작업장이 아닌 In-House 개념의 제품입니다. 빠르고 쉽게 제작할 수 있도록 설계 되어 회로 설계자로 하여금 생산 지연발생 절감 효과와 더불어 외부 벤더들과 일어날 수 있는 가격 경쟁 및 정보 유출을 막을 수 있어 회로 디자이너에게 최고의 경쟁력을 부여할 것입니다.

ProConduct는 0.4mm까지 정확하게 도금 처리되며 더욱더 작은 홀의 경우 특별한 상태에서 제작이 가능하게 됩니다. ProConduct 도금의 전기적 저항은 재료 두께에 따라 조금씩 다르지만 약 0.0192mΩ으로 매우 낮습니다. 전체 진행은 양면과 다층 기판을 포함하여 수 분 내에 완료될 수 있습니다. (열처리 과정 제외)

■ 제품 규격

최소 도금 가능 홀의 크기	0.4 mm (15 mil) up to aspect ratio of 1:4
최대 도금 가능 홀의 갯수	no limit
최대 도금 층수	4
Solderability	reflow soldering 250 ℃, Manual Soldering 380 ℃
Base material types	FR4, FR3, RF and micromave materials (incl. PTFE based materials)
작업 시간	약 35 min
저항 값	average 19.2 mΩ with standard deviation of 7.7mΩ



PCB 도금 공정 (ProConduct)

※ ProConduct에 의한 PCB 도금 공정은 다층 기판의 층별 패턴을 연결해 주는 스루홀 도금 공정이며, 신 개발된 무공해 Paste를 이용하여 쉽고 편리하게 도금할 수 있는 장점과 RF영역에서도 안정적인 특성을 제공합니다.